

Distributed by:

JAMECO[®]
ELECTRONICS

www.Jameco.com ♦ 1-800-831-4242

The content and copyrights of the attached
material are the property of its owner.

Jameco Part Number 1973912



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

[1. 適用範囲 SCOPE]

本仕様書は、

殿 に納入する

1.25 mmピッチ SMT基板用 コネクタ について規定する。This specification covers the 1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT CONNECTOR series.

[2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER]

製品名称 Product Name		製品型番 Part Number
ターミナル Terminal	無鉛 LEAD FREE	50516-****
ハウジング Housing	無鉛 LEAD FREE	51127-***05
ハウジング Housing	無鉛 LEAD FREE	54235-***05
ウェハー アッセンブリ (ボス有り) Wafer Assembly (With Boss)	無鉛 LEAD FREE	53505-***19
53505-***19 エンボス梱包品 Embossed Tape Packaging for 53505-***19	無鉛 LEAD FREE	53505-***71
金属 シェル (30極) Metal Shell (30 Ckts.)	無鉛 LEAD FREE	58398-0300
金属 シェル (20極) Metal Shell (20 Ckts.)	無鉛 LEAD FREE	58399-0200

* : 図面参照 Refer to the drawing.

REV.	A																			
SHEET	1~10																			
REVISE ON PC ONLY										TITLE:										
A 新規作成 RELEASED J2004-2918 '04/03/08 E. SUZUKI										1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT Conn. -LEAD FREE- 製品仕様書										
										THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION										
REV.	DESCRIPTION																			
DESIGN CONTROL J					STATUS					WRITTEN BY: E. SUZUKI	CHECKED BY: K. TOJO	APPROVED BY: M. SASAO	DATE: YR/MO/DAY 2004/03/08							
DOCUMENT NUMBER PS-51127-003															FILE NAME PS51127003.DOC	SHEET 1 OF 10				
EN-37-1(019)																				



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

[3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES]

項目 Item	規格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage(MAX.)	125 V	
最大許容電流 及び適用電線 Rated Current (MAX.) and Applicable wires	AWG#28	1 A
	AWG#30	1 A
	AWG#32	0.8 A
使用温度範囲 Ambient Temperature Range	- 40°C ~ + 85°C*1	

*1 : 通電による温度上昇分も含む。
Including terminal temperature rise.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 10	1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT Conn.	
		-LEAD FREE- 製品仕様	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-51127-003		FILE NAME PS51127003.DOC	SHEET 2 OF 10



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

[4. 性 能 PERFORMANCE]

4 - 1. 電氣的性能 Electrical Performance

項 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1 接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、 短絡電流 10mAにて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate connectors, measure by dry circuit, 20mV MAX., 10mA. (JIS C5402 5.4)	20 milliohm MAX.
4-1-2 絶縁抵抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及び ターミナル、アース間に、DC 500V を印加し測定 する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate connectors, apply 500V DC between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	100 Megohm MIN.
4-1-3 耐電圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及び ターミナル、アース間に、AC (rms) 250V (実効 値) を1分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors, apply 250V AC (rms) for 1 minute between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異常なきこと No Breakdown
4-1-4 圧着部接触抵抗 Contact Resistance On Crimped Portion	ターミナルに適合電線を圧着し、開放電圧20mV 以下、短絡電流10mAにて測定する。 Crimp the applicable wire on to the terminal, Measure by dry circuit , 20mV MAX, 10mA.	5 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 10

TITLE:

1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT Conn.

-LEAD FREE-

製品仕様

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO
MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER

PS-51127-003

FILE NAME

PS51127003.DOC

SHEET

3 OF 10

EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

4 - 2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	毎分 $25 \pm 3\text{mm}$ の速さで 挿入、抜去を行う。 Insert and withdraw connectors At the speed rate of $25 \pm 3\text{mm}/\text{minute}$.	挿入力 Insertion Force	2.1N{0.22kgf}/CKT.MAX.
			抜去力 Withdrawal Force	0.5N{0.05kgf}/CKT.MIN.
4-2-2	圧着部引張り強度 Crimping Pull Out Force	圧着されたターミナルを治具に固 定し、電線を軸方向に毎分 $25 \pm 3\text{mm}$ の速さで引っ張る。 (JIS C5402 6.8) Fix the crimped terminal, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of $25 \pm 3\text{mm}/\text{minute}$. (JIS C5402 6.8)	AWG.#28	9.8 N { 1.0 kgf } MIN.
			AWG.#30	4.9 N { 0.5 kgf } MIN.
			AWG.#32	3.0 N { 0.3 kgf } MIN.
4-2-3	ターミナル挿入力 Terminal Insertion Force	圧着されたターミナルをハウジングに挿入す る。 Insert the crimped terminal into the housing.	9.8 N { 1.0 kgf } MAX.	
4-2-4	ターミナル保持力 Terminal / Housing Retention Force	圧着されたターミナルをハウジングに装着し、 電線を軸方向に毎分 $25 \pm 3\text{mm}$ の速さで引っ張 る。 Apply axial pull out force at the speed rate of $25 \pm 3\text{mm}/\text{minute}$ on the terminal assembled in the housing.	4.9 N { 0.5 kgf } MIN.	
4-2-5	金具保持力 Fitting nail / Housing Retention Force	毎分 $25 \pm 3\text{mm}$ の速さで ピンを軸方向に押す。 Apply axial push force at the speed rate of $25 \pm 3\text{mm}/\text{minute}$ on the fitting nail assembled in the housing.	4.0 N { 0.4 kgf } MIN.	

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 10

TITLE:

1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT Conn.

-LEAD FREE-

製品仕様

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO
MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER

PS-51127-003FILE NAME
PS51127003.DOCSHEET
4 OF 10

EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰返し挿抜 Repeated Insertion/ Withdrawal	1分間10回以下の速さで挿入、抜去を50回繰返す。 When mated up to 50 cycles repeatedly By the rate of 10 cycles per minute.	接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、最大許容電流を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Carrying rated current load. (UL498)	温度上昇 Tempera- ture-rise	30 °C MAX.
4-3-3	耐振動性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に掃引割合10~55~10 Hz/分全振幅1.5mmの振動を各2時間加える。 (MIL-STD-202 試験法 201) Amplitude : 1.5mm P-P Sweep time : 10~55~10 Hz in 1 minute Duration : 2 hours in each X.Y.Z. axes (MIL-STD-202 Method 201)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			瞬断 Discontinuity	1.0 microsecond MAX.
4-3-4	耐衝撃性 Shock	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な6方向に490m/s ² {50G}の衝撃を各3回加える。 (JIS C0041/MIL-STD-202 試験法 213) 490m/s ² {50G}, 3 strokes in each X.Y.Z. axes. (JIS C0041/MIL-STD-202 Method 213)	外観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			瞬断 Discontinuity	1.0 microsecond MAX.

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 10

TITLE:

1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT Conn.

-LEAD FREE-

製品仕様

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER

PS-51127-003FILE NAME
PS51127003.DOCSHEET
5 OF 10



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-5	耐熱性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、85±2°Cの雰囲気中に96時間放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C0021/MIL-STD-202 試験法108) 85±2°C, 96hours (JIS C0021/MIL-STD-202 Method 108)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	コネクタを嵌合させ、-40±3°Cの雰囲気中に96時間放置後取り出し、1~2時間室温に放置する。 (JIS C0020) -40±3°C, 96hours (JIS C0020)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-7	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合させ、60±2°C、相対湿度90~95%の雰囲気中に96時間放置後取り出し、1~2時間室温に放置する。 (JIS C0022/MIL-STD-202 試験法103) Temperature : 60±2°C Relative Humidity : 90~95% Duration : 96 hours (JIS C0022/MIL-STD-202 Method 103)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
			耐電圧 Dielectric Strength	4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	10 Megohm MIN.

REVISE ON PC ONLY

A

SEE SHEET 1 OF 10

TITLE:

1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT Conn.

-LEAD FREE-

製品仕様

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER

PS-51127-003FILE NAME
PS51127003.DOCSHEET
6 OF 10

EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、-55°Cに30分、+105°Cに30分、これを1サイクルとし、5サイクル繰り返す。 但し、温度移行時間は5分以内とする。 試験後1~2時間室温に放置する。 (JIS C0025) 5 cycles of : 1) - 55 °C 30 minutes 2) +105°C 30 minutes (JIS C0025)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-9	塩水噴霧 Salt Spray	コネクタを嵌合させ、35±2°Cにて 5±1%重量比の塩水を48±4時間噴霧し試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C0023/MIL-STD-202 試験法101) 48±4 hours exposure to a salt spray from the 5±1% solution at 35±2°C. (JIS C0023/MIL-STD-202 Method 101)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-10	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	コネクタを嵌合させ、40±2°Cにて 50±5ppmの亜硫酸ガス中に24時間放置する。 24 hours exposure to 50±5ppm. SO ₂ gas at 40±2°C.	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.
4-3-11	耐アンモニア性 NH ₃ Gas	コネクタを嵌合させ、濃度28%のアンモニア水を入れた容器中に40分間放置する。 (1Lに対して25mLの割合) 40 minutes exposure to NH ₃ gas evaporating from 28% Ammonia solution.	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	40 milliohm MAX.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 10	1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT Conn.	
		-LEAD FREE- 製品仕様	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-51127-003		FILE NAME PS51127003.DOC	SHEET 7 OF 10



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-12	半田付け性 Solderability	端子先端より0.5mm、金具先端より0.5mmの位置まで245±3℃の半田に3±0.5秒浸す。 Soldering Time : 3±0.5 sec. Solder Temperature : 245±3℃ 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip.	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes.
4-3-13	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	(リフロー時) <u>Refer soldering method</u> 第6項参照 Refer to paragraph 6 , condition two times.	外観 Appearance	端子ガタ、割れ等 異状なきこと No Damage
		(手半田時) <u>Soldering iron method</u> 端子先端より0.5mm、金具先端より0.5mmの位置まで370~400℃の半田ゴテにて 最大5秒加熱する。 (Soldering iron method) Solder Time : 5 sec MAX. Solder Temperature: 370~400℃ 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip.		

(): 参考規格 Reference Standard
{ }: 参考単位 Reference Unit

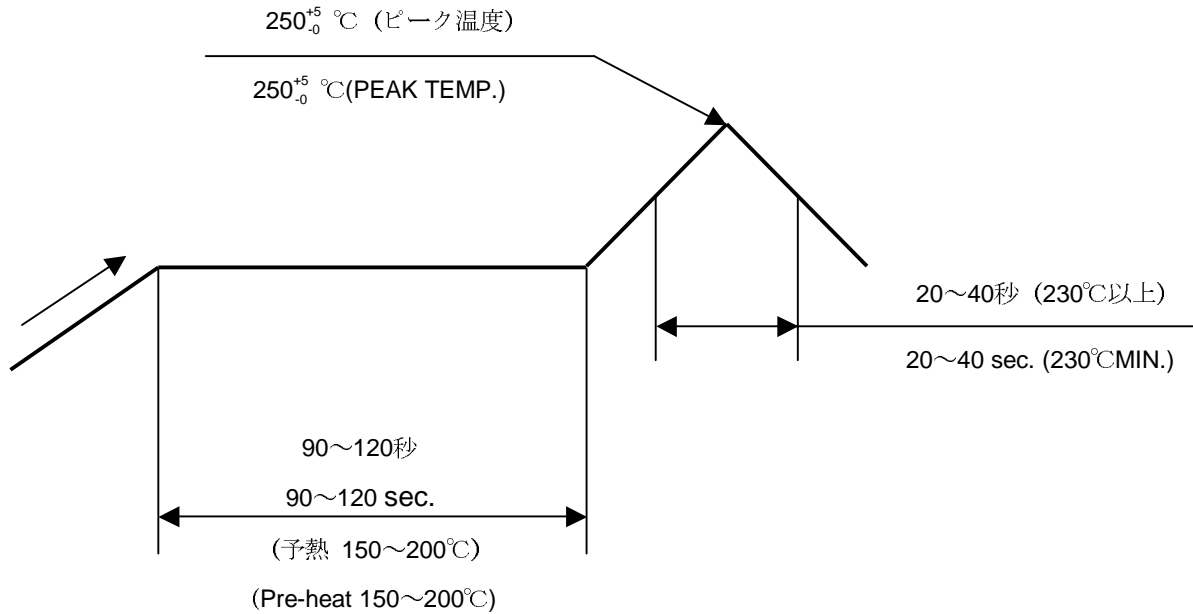
【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照 Refer to the drawing.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 10	1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT Conn. -LEAD FREE- 製品仕様	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER PS-51127-003		FILE NAME PS51127003.DOC	SHEET 8 OF 10



[6. 赤外リフロー条件 INFRARED REFLOW CONDITION]



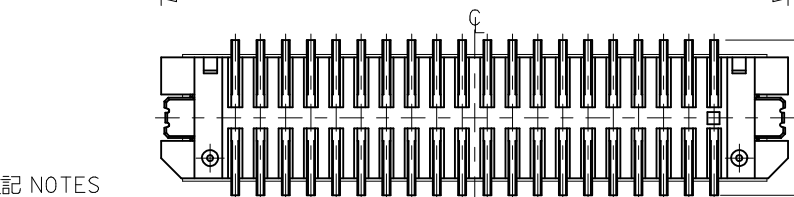
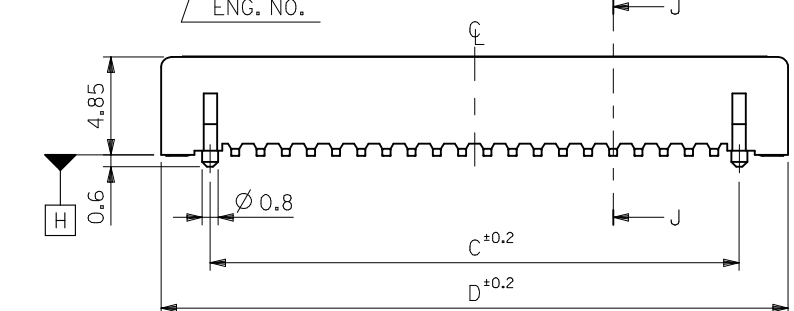
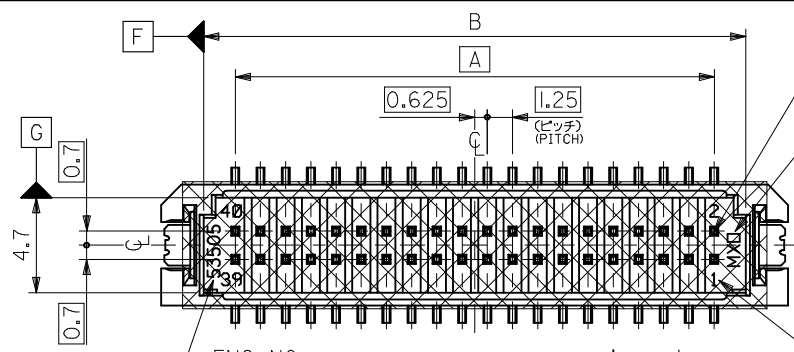
温度条件グラフ
TEMPERATURE CONDITION GRAPH
 (基板表面温度)
 (TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE)

注記：本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので
 事前に実装評価(リフロー評価)の御確認を御願い致します。

NOTE : Please check the mount condition (reflow soldering condition) by your own devices
 beforehand,
 because the condition changes by the soldering devices, p.c.boards, and so on.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
A	SEE SHEET 1 OF 10	1.25mm PITCH WIRE TO BOARD SMT Conn.	
		-LEAD FREE- 製品仕様	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-51127-003		FILE NAME PS51127003.DOC	SHEET 9 OF 10

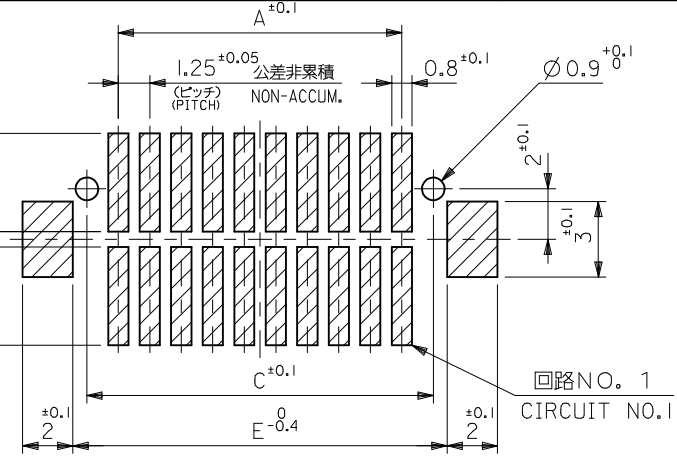
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



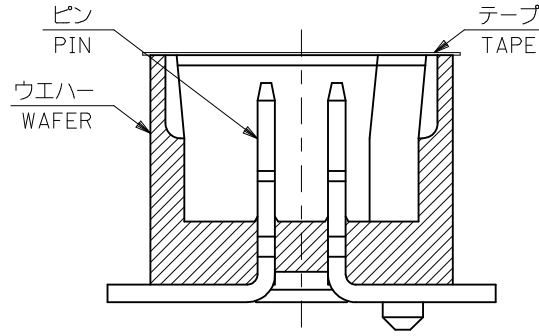
TRADE MARK
 $\phi \ 0.4$ F G

CIRCUI T NO.
 回路番号

金具
 NAIL



推奨基板寸法 (参考)
 RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
 (REFERENCE)



SECT. J-J
 (SCALE 10:1)

注記 NOTES

- 1 嵌合相手 : 51127 シリーズ
 MATE WITH : 51127 SERIES
- 2 使用材料 MATERIAL
 ウエハー : ガラス入り PPA, UL94V-0
 WAFER : G.F. PPA, UL94V-0
 ピン : リン青銅 (t=0.35)
 PIN : PHOSPHOR BRONZE (t=0.35)
 金メッキ 0.2 MICROMETER MIN.
 Au
 錫メッキ 1.0 MICROMETER MIN.
 Sn
 ニッケル下地 2.0 MICROMETER MIN.
 Ni(UNDER)
 金具 : リン青銅 (t=0.2)
 NAIL : PHOSPHOR BRONZE (t=0.2)
 錫メッキ 1.0 MICROMETER MIN.
 Sn
 ニッケル下地 1.0 MICROMETER MIN.
 Ni(UNDER)
 テープ : ポリイミド (t=50 μm)
 TAPE : PI (t=50 μm)

- 4 ピン及び金具の半田付け面のバラツキ寸法
 PIN AND NAIL COPLANARITY
 [H]面を基準とし、上へ 0 下へ 0.1 の範囲とする。
 TAILS TO BE WITHIN 0 UPWARD AND
 0.1 DOWNWARD FROM [H] PLANE.
- 5 本製品は53505-**-**10の鉛フリー品である。
 THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53505-**-**10.
6. ELV 及び RoHS適合品
 ELV AND RoHS COMPLIANT.

21.1	24.85	20.0	20.65	17.5	53505-3019	30
E	D	C	B	A	MATERIAL NO.	CKT. 極数

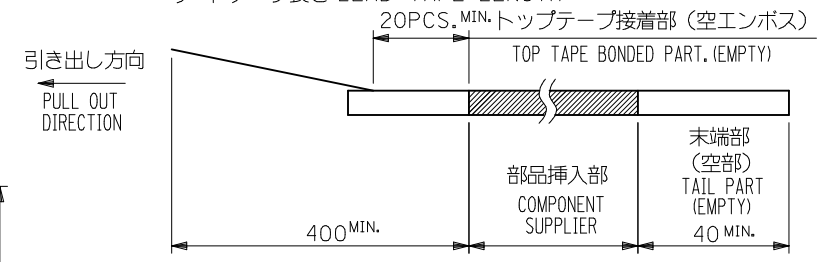
				53505-**-**19		MODEL NO.
--	--	--	--	---------------	--	-----------

VOIDED	EC NO: J2009-0588	2008/12/04	DRWN: YOSHIDAM
	2008/12/04	CHKD: THARUYAMA	2009/01/09
	2009/01/09	APPR: NUKITA	
	REV	DESCRIPTION	

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 4:1		DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION	
10 UNDER	±0.2	DRAWN BY	DATE	TITLE 1.25 DUAL W/B CONN WAFER ASSY					
10 OVER 30 UNDER	±0.25	Y. WADA	'04/02/10	CHECKED BY M. SASAO					
30 OVER	±0.3	M. SASAO	'04/02/10	APPROVED BY M. SASAO					
ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		MOLEX INCORPORATED			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		SEE TABLE		SD-53505-001			
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION									

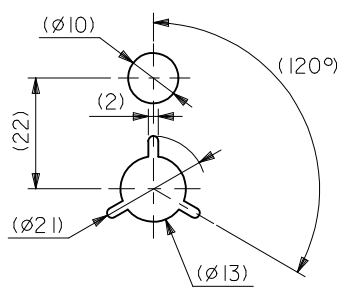
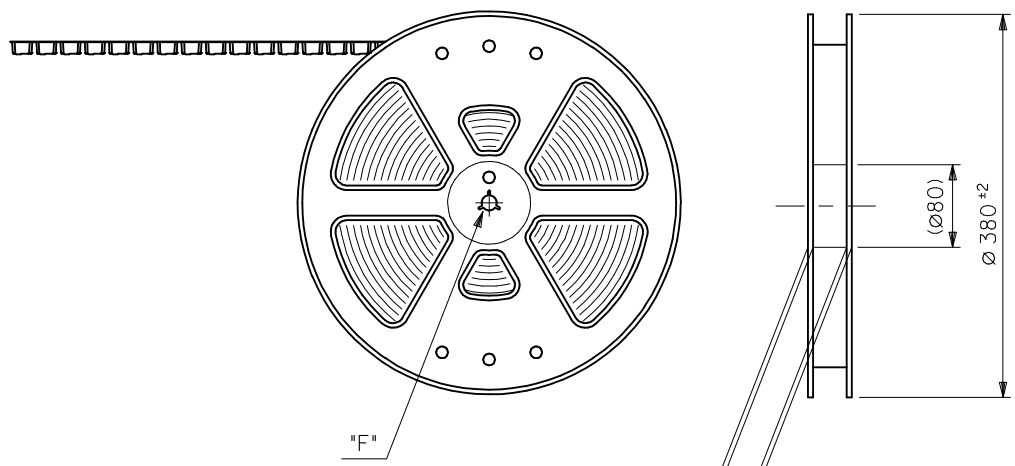
NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-53505-001 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-53505-001
- 梱包数量：1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



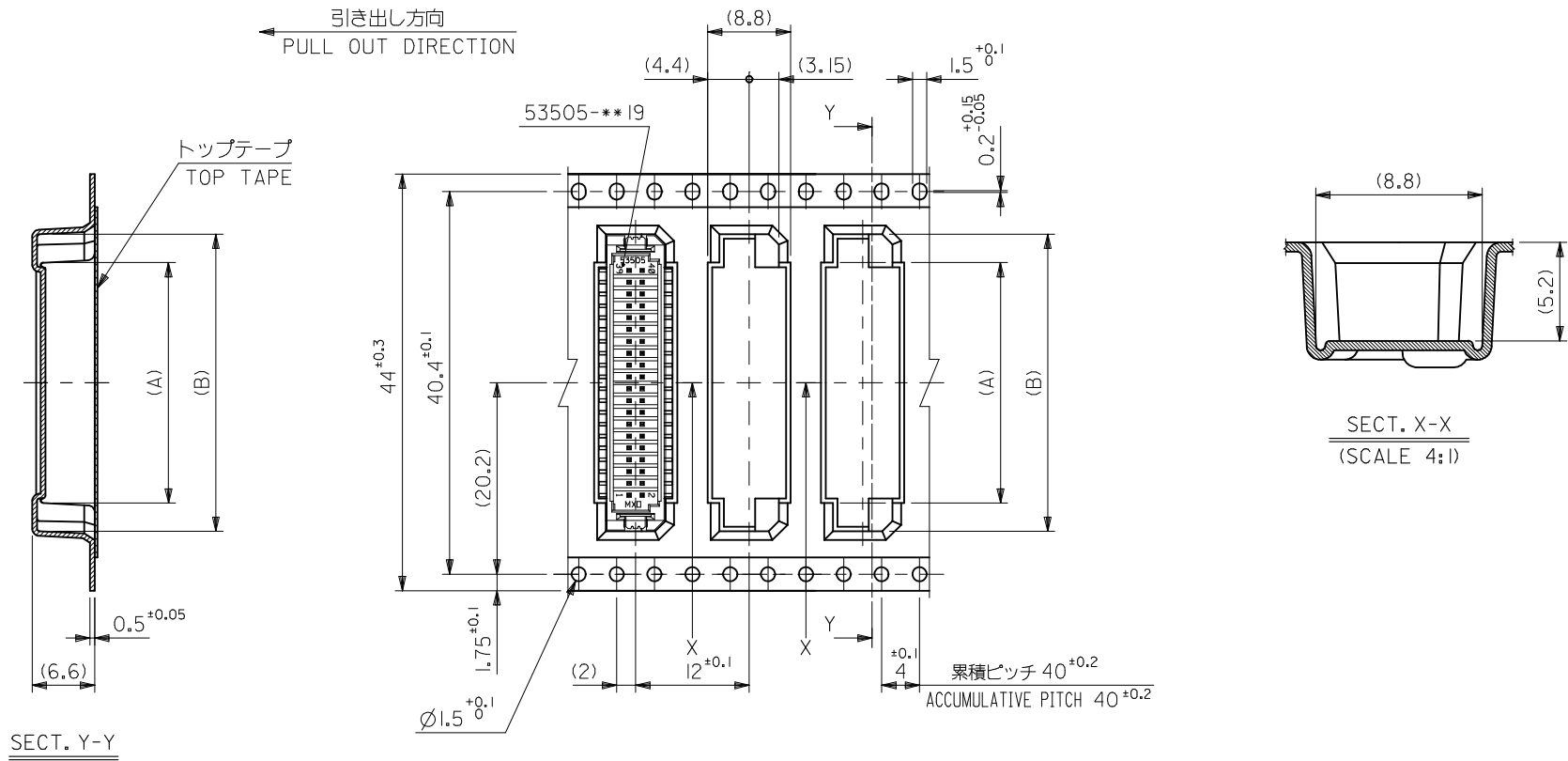
- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE) : PET, PE, PEF
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- 本製品は53505-***90の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53505-***90.
- ELV 及び RoHS 適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT.

引き出し方向
PULL OUT



DETAIL "F"

REVISED EC NO: J2009-0588 DRWN: YOSHIDAM 2008/12/04 CHKD: THARUYAMA 2008/12/04 APPR: NUKITA 2009/01/09	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	53505-***71	MODEL NO.
	10 UNDER	±0.2	DRAWN BY Y. WADA	DATE '04/02/10	TITLE	125 DUAL W/B CONN WAFER ASSY EMBSTP PKG	
	10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/10	MOLEX INCORPORATED SD-53505-002		
	30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/10			
ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO. SEE SHEET 2		DOCUMENT NO.		SD-53505-002	
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					



44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

44	49.4	45.4	25.15	19.15	53505-3071	30
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

REVISED EC NO: J2009-0588 DRWN: YOSHIDAM 2008/12/04 CHKD: THARUYAMA 2008/12/04 APPR: NUKITA 2009/01/09	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION
	10 UNDER	± ---	DRAWN BY Y. WADA	DATE '04/02/10	TITLE 1.25 DUAL W/B CONN WAFER ASSY EMBSTP PKG		
	10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY M. SASAO	DATE '04/02/10			
	30 OVER	± ---	APPROVED BY M. SASAO	DATE '04/02/10	MOLEX INCORPORATED		
ANGULAR ± --- °		MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-53505-002			2 OF 2
		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					